

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：P711P207

※ 申請日期：P7.5.23

※IPC 分類：E04B 5/48(2006.01)
E04B 1/70(2006.01)
E04F 15/16(2006.01)
E04F 17/00(2006.01)

一、發明名稱：(中文/英文)

地板構件

FLOOR MEMBER

二、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

特魯森林有限公司 / TRU WOODS LIMITED

代表人：(中文/英文)

史東 諾曼 / STONE, NORMAN

住居所或營業所地址：(中文/英文)

香港銅鑼灣怡和街 28 號

28 Yee Woo Street, Causeway Bay, Hong Kong.

國 籍：(中文/英文)

香港 / HONG KONG

三、發明人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

史東 諾曼 / STONE, NORMAN

國 籍：(中文/英文)

美國 / U. S. A.

四、聲明事項：

☐ 主張專利法第二十二條第二項 ☐ 第一款或 ☐ 第二款規定之事實，其事實發生日期為：。

☒ 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

☒ 有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

1. 美國、 2007/05/25、 60/940,141
2. 美國、 2008/05/16、 12/122,463

☐ 無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

☐ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

☐ 主張專利法第三十條生物材料：

☐ 須寄存生物材料者：

國內生物材料 【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料 【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

☐ 不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

發明領域

本發明關於直接安裝至地板基底而不用黏著於地板基
5 底的地板構件，更特定地，關於容許地板基底及地板構件
間發展的濕氣移動或分散於地板構件外以散發於周圍空氣
中的地板構件。

本發明也關於當地板構件被踩踏時且當個體移動於其
10 上時，可吸收大量鞋子衝擊噪音及個體移動噪音的地板構
件。

此處所用之術語“地板構件”意指層疊的木板地板及
層疊的瓷磚地板。然而為簡化本發明描述之故，該術語將
用以描述瓷磚地板。但應了解者，本發明也涵括木板地
板。因此與術語“瓷磚地板”描述相關的概念及結構也適用
15 於木板地板。

術語“瓷磚地板”也包括通常被稱為木瓷磚、纖維板瓷
磚、軟木塞瓷磚、地毯瓷磚、塑膠瓷磚與橡膠瓷磚的瓷磚
地板。

【先前技術】

20 發明背景

若安裝在吸收或散發濕氣的表面上，諸如在地下室、
車庫或其他地面以下地方的地板基底表面上，已知的層疊
瓷磚地板容易受水傷。此濕氣通常被捕捉於瓷磚及地板基
底之間。

當瓷磚地板安裝於暴露至濕氣的地板基底上，地板基底上的瓷磚會吸收被捕捉的濕氣，然後擴張，最後造成瓷磚的扭曲及彎曲。通常，扭曲的瓷磚地板係永久地發生使得瓷磚不可回復地變形。

- 5 有時扭曲或彎曲的瓷磚地板會從地板基底爆開或掀起且造成一個以上鄰近的瓷磚從地板基底離位。

所以需要替換扭曲的瓷磚及再度固定或替換離位的瓷磚。

- 10 如果瓷磚地板具有互鎖總成系統，諸如已知的“按鎖(click and lock)系統”或已知的“榫舌(tongue and groove)系統”，則瓷磚替換程序會變得繁複與昂貴，通常牽涉鑽孔與鋸開以分離及除去要替換的瓷磚。常常瓷磚的修理與替換必須重複實行，特別是如果地板基底持續有濕氣問題的話。

- 15 當走在上面時一些已知的層疊瓷磚地板容易放大鞋子噪音，而當個體移動在瓷磚上時其等也容易放大移動噪音。

所以需要提供一種可以容許地板構件下方發展的濕氣從地板構件移動出去的地板構件。也需要提供一種可以吸收鞋子噪音及減少移動於地板構件表面上之個體所產生之移動噪音的地板構件。

20 **【發明內容】**

發明概要

一種層疊地板構件，其安裝在地板基底上而無需將該地板構件結合或黏結至該地板基底，該地板構件包括封閉外周的一第一地板構件部份及層疊至該第一地板構件部份

上之封閉外周之一第二地板構件部份，該第一地板構件部份包括用於行走於其上之一頂表面，該第二地板構件部份具有含周圍側邊緣之一底部份，該底部份形成有引導朝向該底部份之周圍側邊緣的數個濕氣分散路徑以允許發展於該地板基底及安裝於地板基底上之該地板構件之底部份之間的濕氣流動於該濕氣分散路徑中，而朝向該底部份之至少一周圍側邊緣，並通過至該底部份之至少一周圍側邊緣的外邊。

一種能夠使發展於地板基底與安裝在該地板基底上之地板構件之間的濕氣移動至該地板構件之最外邊緣以通過至該地板構件之最外邊緣之外邊的方法，包括：於該地板構件備置有一第一地板構件部份，該第一地板構件部份具有用於走在其上之一頂表面；層疊該第一地板構件部份至一第二地板構件部份，該第二地板構件部份具有含周圍側邊緣之一防水塑膠底部份；及使該底部份形成有濕氣分散路徑，該濕氣分散路徑沿著該底部份延展至該底部份之周圍側邊緣以當安裝於該地板基底上而未結合或黏結至該地板基底時，使得發展於地板基底及該地板構件之底部份之間的濕氣能夠經由該濕氣分散路徑朝向該底部份之至少一周圍邊緣移動而通過至該底部份之至少一周圍側邊緣的外邊。

圖式簡單說明

第1圖為併入本發明一實施例之地板構件的簡化立體圖；

第2圖為此地板構件之總成圖案的立體圖；

第3圖為沿著第2圖線3-3之簡化截面圖；

第4圖為沿著第2圖線4-4之簡化截面圖；

第5圖為地板構件一實施例之的層疊段詳細立體圖；

5 第6圖為沿著第9圖線6-6之地板構件的片段截面圖；

第7圖為第6圖地板構件之下側放大的片段立體圖，地板基底以簡化線條表示；

第8圖地板構件之下側的簡化平面圖；及

第9圖為安裝在地板基底上之地板構件總成之下側的
10 簡化平面，地板基底為清楚之故予以省略。

對應的標號表示各圖式之對應的部份。

【實施方式】

較佳實施例之詳細說明

參考圖式，本發明地板構件之一實施例為如第1圖所示
15 之瓷磚地板的形式，且通常以標號10表示。

瓷磚地板10包括相同尺寸及形狀之第一地板構件部份
14及第二地板構件部份16。於本發明較佳實施例中，第一
地板構件部份14層疊至第二地板構件部份16，使得第一地
板構件部份14與第二地板構件部份16間具有一預定的偏
20 移，如同吾人美國專利第7,155,871號、第7,322,159號及申
請於2006年11月9日之吾人美國申請案第11/595,599號中所
描述的方式，其等之全部內容併入此處作為參考。

於第一及第二地板構件部份14及16之偏移排列中，第
一地板構件部份14之側邊緣26 (第1圖)較第二地板構件部

份16的對應側邊緣32向外延展一偏移量“a”。第一地板構件部份14垂直側邊緣26之另一側邊緣34較第二地板構件部份16之對應側邊緣40向外延展相同的偏移量“a”。側邊緣26及34之偏移因此界定了第一地板構件部份14之一偏移L形周緣段42 (第1圖)。

於第一及第二地板構件部份14及16之偏移排列中，第二地板構件部份16之側邊緣46 (第1圖)較第一地板構件部份14之對應側邊緣48向外延展一偏移量“a”。第二地板構件部份16垂直側邊緣46之另一側邊緣50較第一地板構件部份14之對應側邊緣56向外延展相同的偏移量“a”。側邊緣46及50之偏移因此界定了第二地板構件部份16之一偏移L形周緣段58 (第1圖)。

第一地板構件部份14之L形周緣段42及第二地板構件部份16之L形周緣段58具有相同尺寸及形狀。

用於將第一地板構件部份14及第二地板構件部份16層疊在一起的合適黏結或黏著組成物具有以下的組份，其等之量為大約的值：

- a) 35% SIS (苯乙烯-異戊烯-苯乙烯彈性體)
- b) 54.5%石油樹脂
- c) 10%礦物油
- d) 0.05%抗氧化劑BHT (2,6-二-三級-丁基-p-甲酚)。

第一及第二地板構件部份14及16的黏結物質提供於第一地板構件部份14之下表面64(第3圖)及第二地板構件部份16之上表面66上。

L形周緣段42具有向下的黏著表面72(第1及3圖), 其為第一地板構件部份14之下表面64 (第3圖)的一部份, L形周緣段58具有向上的黏著表面74(第1及3圖), 其為第二地板構件部份16之上表面66 (第3圖)的一部份。在暴露的黏著表面72及74上的黏著劑為用於將第一地板構件部份14及第二地板構件部份16層疊在一起的黏結物質。

雖然瓷磚地板10的尺寸可選擇, 第一地板構件部份14及第二地板構件部份16的合適尺寸可為例如18吋×18吋。更大或更小尺寸的正方形瓷磚也是可以選擇的。第一地板構件部份14的厚度可為例如大約2.0mm且第二地板構件部份16的厚度可為例如大約2.5mm。周緣偏移 “a”可為例如大約1 吋。偏移量也是可選擇的, 更大或更小的偏移也是可以的。

第5圖顯示瓷磚地板10已知之眾多可能層疊構形之一者。若地板10例如為纖維板瓷磚, 瓷磚地板10之第一地板構件部份14可包括三聚氰胺形成的上層疊段190。上層疊段190之頂表面192得以合適已知方式製造之設計形式(諸如木紋)提供(未圖示)。

想要的話, 上層疊段190之頂表面192可以合適已知之清潔保護熱定型樹脂(未圖示)以已知方式塗覆或灌注來提供抗磨損及抗刮痕特性。

上層疊段190可以合適已知方式被層疊於纖維板或硬板層疊段194上。

纖維板層疊段194可以合適已知方式被層疊於平衡片

或平衡層層疊段196（諸如以三聚氰胺樹脂注入的卡夫特（Kraft）紙板）上。平衡層層疊段196藉著使層疊於平衡層層疊段196上方及下方之不同材料之不同擴張係數的影響降到最低以提供瓷磚地板10尺寸穩定性，及因此幫助遏止瓷
5 磚地板10的彎折、低陷或拱起。

第一地板構件部份14也可包括由已知塑膠材料，諸如半堅硬之聚氯乙烯，形成之下傳送層層疊段198（第5圖），其以合適已知方式層疊於平衡層層疊段196。下傳送層層疊段198可幫助防止濕氣通過平衡層層疊段196至纖維板層疊
10 段194。

第一地板構件部份14之下表面64（第3圖）也是傳送層層疊段198之下表面，所以包括向下的黏著表面72。

第二地板構件部份16包括已知塑膠材料，諸如均質聚氯乙烯材料，形成之攜帶層200（第5圖），其以合適已知方
15 式以上述偏移關係層疊至第一地板構件部份14。

第二地板構件部份16之上表面66（第3圖）也是攜帶層200之上表面，所以包括向上的黏著表面74。

參看第6、7及8圖，第二地板構件部份16包括與數個濕氣分散或濕氣移動路徑一起形成之底部份208，該濕氣分散
20 或濕氣移動路徑包括通道220及路徑242，如於第7圖清楚顯示者。通道220為在底部份208以重複圖案形成之間隔壁部份228所界定，如此使得通道220成一個接著另一個排列。壁部份228具有自由端表面230（第6圖），其從底部份208之下表面234突出一預定量。

壁部份228也備有中斷處諸如240(第7圖)。一壁部份228之中斷處240的其中一者大致上與另一壁部份228之對應中斷處240對齊，如此該對齊的中斷處240界定了濕氣分散路徑242。

- 5 相似地，壁部份228(第8圖)中其他的對應中斷處240係大致上對齊的，如此對應的對齊中斷處240界定了對齊中斷處240之其他個別的濕氣分散路徑242。

底部份208(第7圖)也與數個似柱狀的構成物或突出物250一起形成。該管柱250係位於通道220內且位於對齊中斷處240之路徑242內，但最好不要在中斷點的地方。管柱250
10 的尺寸可允許濕氣經由通道220及經由對齊中斷處240之路徑242移動通過管柱250，如第7圖中之濕氣移動箭頭所示。

管柱250具有一自由端表面256(第6圖)，其從下表面234突出的量與壁部份端表面230從下表面234突出的量大致相
15 同。較佳地，管柱250之端表面256與壁部份228之端表面230係大致上共平面，如第6圖清楚顯示者。

管柱250之橫截面通常為圓形且從端表面256至下表面234(第6圖)具有一稍微分叉的尖形。

間隔壁部份228及管柱250的功能為當瓷磚地板10安裝
20 於地板基底266上時，將下表面234與地板基底266分隔一定距離或量260(第6圖)。距離260大約等於壁部份端表面230與管柱端表面256從底部份208下表面234突出的量。

於此排列下，在底部份208的下表面234被壁部份228及管柱250從地板基底266大致上提高了距離260(第6圖)。

因為壁部份228及管柱250將下表面234與地板基底266
分隔，所以地板基底266與瓷磚地板10下表面234之間發展
的濕氣可經由通道220與對齊中斷處240之路徑242移動至
瓷磚地板10之至少一個側邊緣32、40、46與50的外邊(第8
5 圖)，藉此避免濕氣被捕捉於瓷磚10及地板基底266之間。

參看第8圖，通道220界定了從瓷磚10之一側邊緣46延
展至相對側邊緣32的一濕氣分散路徑。壁部份228具有波浪
形狀，其界定出通道220的波浪路徑。壁228之形狀係可選
擇的，其他壁形狀諸如 直線壁或非波浪彎壁(未圖示)也是
10 可以的。

再參看第8圖，對齊中斷處240之路徑242通常從瓷磚10
之側邊緣40延展至相對側邊緣50。因此通道220及對齊中斷
處240之路徑242構成了開口於底部份208之周圍邊緣32、
40、46與50的濕氣分散或移動路徑。因此，地板基底266及
15 安裝於地板基底266上之瓷磚地板10之底208之間發展的濕
氣可以如第6圖所示的方式流動、分散或移動於路徑220及
242內且朝向底部份208之周圍邊緣32、40、46與50的至少
一者，藉此避免濕氣被圈住於瓷磚地板10及地板基底266之
間。

20 於一些例子中，瓷磚地板之底部份208可與通道220一
起形成，該通道係與其他通道220交叉。例如，於第9圖之
瓷磚總成80所示，瓷磚10a具有兩個不同且交叉的濕氣路徑
圖案(270及272)，該等濕氣路徑圖案交叉於界線274之一
非突出線處。總成80(第9圖)之另一瓷磚地板10b具有例如

三條交叉路徑圖案278、280及282，其等為界線274，274之非突出線所分割。

雖然瓷磚10a之路徑圖案270及272交叉且瓷磚10b之路徑圖案278、280及282交叉，瓷磚10a之每個圖案270及272
5 的濕氣分散路徑之間仍然具有溝通且瓷磚10b之路徑圖案278、280及282的濕氣分散路徑之間仍然具有溝通。

例如，橫過交叉路徑圖案270及272之間的界線274之線(第9圖)，在圖案270中之對齊中斷處的路徑242之間，以及在圖案272中之通道220之間具有溝通。

10 以相似的方式，圖案270之通道220之間以及瓷磚10a圖案272之通道220之間具有溝通。橫過界線274、274的線，相似的溝通發生於瓷磚10b的路徑圖案278、280及282之間。

所以，具交叉路徑圖案270及272之瓷磚地板10a，及具交叉路徑圖案278、280及282之瓷磚地板10b允許濕氣移動
15 至於其等個別底部份208 (第7圖)之邊緣32、40、46及50之至少一者的外部以使得瓷磚10a及10b可以與鄰近瓷磚之濕氣分散路徑互相溝通。

在相鄰關係之瓷磚地板10安裝期間，諸如第2圖之瓷磚總成圖案80所示，頂層14之L形周緣段42的向下黏著表面72
20 (第1圖)係用以接合底層16之L形周緣段58的向上黏著表面74以將一瓷磚10與另一瓷磚10結合在一起且藉此形成瓷磚總成80。

當將兩個瓷磚地板10放在一起時，一個瓷磚10對於地板基底266大約呈45度的角度(未圖示)，且放置於鄰近瓷磚

地板10之對應的向上面對黏著表面74 (第1圖)上。

瓷磚地板總成圖案80 (第2圖)僅是習於此藝者已知之多個可能的瓷磚地板安裝圖案的一個例子。

瓷磚地板10係較佳地安裝在地板基底266上而不需要
 5 塗在底部份208或地板基底266上的任何灰泥或黏著劑。不需灰泥的將瓷磚10安裝於地板基底102上使得濕氣分散路徑220及242保持開啟且讓自我安裝瓷磚地板10變得更方便。因此於安裝期間，瓷磚地板10可以容易地在地板基底266上移動至任何選定的位置，藉此便於瓷磚地板10安裝成
 10 任何想要的圖案。

較佳地，瓷磚地板10的安裝應該從房間300的角落294(第9圖)開始及由角落294朝外繼續，角落294係由交叉之壁部份306及308界定。

例如大約 $\frac{1}{4}$ 吋擴張間隙314(第6圖)通常備置於瓷磚
 15 地板總成80之最外邊緣及鄰近壁之間。第9圖中之擴張間隙314也位於瓷磚地板總成80之兩最外邊緣320及322與鄰近壁306及308之間。擴張間隙314，如於第6圖清楚顯示者，容納瓷磚地板總成80安裝於地板基底266上之後發生的瓷磚地板擴張。

20 於一些例子中，鄰近壁306及308之瓷磚地板總成80的最外邊緣320及322(第9圖)包括以任何合適已知方式修整或減少尺寸之修整的瓷磚10c來將所要的圖案總成80安裝在房間300內。

擴張間隙314通常為模件328(第6圖)覆蓋。然而模件328

不會在擴張間隙314上形成空氣緊閉或濕氣緊閉密封。擴張間隙314容許任何移動至擴張間隙314濕氣過模件328散發進入周圍空氣中，如第6及7圖的濕氣流動箭頭所示。

因此，任何發展於瓷磚總成80及瓷磚安裝於其上之地
5 板基底266之間的濕氣不會被捕捉且可移動通過鄰近瓷磚之可溝通的濕氣分散或濕氣移動路徑220及242。濕氣將持續移動至瓷磚地板總成80之至少一個最外邊緣而進入擴張間隙314且散發至周圍空氣中。

濕氣分散路徑220及242也被發現可以消除踩在瓷磚10
10 表面上的聲響。例如當走在地板10瓷磚上時發生的鞋子撞擊噪音以及個體移動在瓷磚10上時發生的噪音被路徑220及242消音或吸收，如此沒有或僅有很少的噪音放大，若缺少此處揭露之濕氣分散路徑，則瓷磚地板通常會產生噪音放大的結果。

15 濕氣分散路徑220及242與管柱250的精確尺寸因著不同款式及不同尺寸的地板構件而變化。但是，為了例示尺寸大小，壁構件228的厚度大約為3至3.5毫米，由下表面234突出之壁構件228之端表面230的量大約為0.10至0.20毫米。壁構件228之間的間隔大約為4.0至4.5毫米，未修整瓷
20 磚10中之中斷處之間之壁構件228的長度為大約16至17厘米，此大致為中斷處240之間的距離。中斷處240之寬度為大約2至3毫米。管柱250之直徑為大約1.9至2.1毫米，通道220中連續管柱250之間的距離為大約12至14毫米。

由於上述之構成及方法可為各種之變化而不會脫離發

明的範圍，所以上面描述或附隨圖式中包含的所有事物應被認為僅是闡述說明而非限制。

【圖式簡單說明】

第1圖為併入本發明一實施例之地板構件的簡化立體
5 圖；

第2圖為此地板構件之總成圖案的立體圖；

第3圖為沿著第2圖線3-3之簡化截面圖；

第4圖為沿著第2圖線4-4之簡化截面圖；

第5圖為地板構件一實施例之的層疊段詳細立體圖；

10 第6圖為沿著第9圖線6-6之地板構件的片段截面圖；

第7圖為第6圖地板構件之下側放大的片段立體圖，地板基底以簡化線條表示；

第8圖地板構件之下側的簡化平面圖；及

15 第9圖為安裝在地板基底上之地板構件總成之下側的簡化平面，地板基底為清楚之故予以省略。

【主要元件符號說明】

10... 瓷磚地板	32... 側邊緣
10a... 瓷磚	34... 側邊緣
10b... 瓷磚	40... 側邊緣
10c... 瓷磚	42... 偏移L形周緣段
14... 第一地板構件部份	46... 側邊緣
16... 第二地板構件部份	48... 側邊緣
26... 側邊緣	50... 側邊緣

56... 側邊緣	242... 路徑
58... 偏移L形周緣段	250... 管柱
64... 下表面	256... 端表面
66... 上表面	260... 距離
72... 黏著表面	266... 地板基底
74... 黏著表面	270... 路徑圖案
80... 瓷磚總成	272... 路徑圖案
190... 層疊段	274... 界線
192... 頂表面	278... 路徑圖案
194... 層疊段	280... 路徑圖案
196... 層疊段	282... 路徑圖案
198... 層疊段	294... 角落
200... 攜帶層	300... 房間
208... 底部份	306... 壁
220... 通道	308... 壁
228... 壁部份	314... 擴張間
230... 端表面	320... 最外邊緣
234... 下表面	322... 最外邊緣
240... 中斷處	328... 模件

五、中文發明摘要：

該地板構件係瓷磚地板或木板地板形式的層疊結構。該地板構件之底部份形成有朝向該底部份之周圍側邊緣的數個濕氣分散路徑。該濕氣分散路徑允許發展於地板基底及安裝於該地板基底上之地板構件之底部份之間的濕氣流動於該濕氣分散路徑中，且朝向該底部份之至少一周圍側邊緣，而通過至該底部份之該周圍側邊緣的外邊。瓷磚地板安裝件之相鄰瓷磚具有溝通的濕氣分散路徑，使得濕氣不會被捕捉於該地板構件的下方且可經由該溝通路徑移動至該瓷磚地板安裝件之最外周圍側邊緣來發散濕氣進入周圍空氣中。

六、英文發明摘要：

The floor member is a laminated structure in the form a floor tile or a floor plank. A bottom portion of the floor member is formed with a plurality of moisture dispersal pathways that lead toward peripheral side edges of the bottom portion. The moisture dispersal pathways permit any moisture that develops between a floor base and the bottom portion of the floor member that is installed on the floor base to flow in the moisture dispersal pathways toward at least one of the peripheral side edges of the bottom portion, for passage beyond the one peripheral side edge of the bottom portion. Adjacent tiles of a floor tile installation have communicable moisture dispersal pathways such that moisture is not entrapped below the floor member and can migrate through the communicable pathways to an outermost peripheral side edge of the floor tile installation for dissipation of moisture into the ambient air.

十、申請專利範圍：

1. 一種層疊地板構件，其安裝在地板基底上而無需將該地板構件結合或黏結至該地板基底，該地板構件包括封閉外周的一第一地板構件部份及層疊至該第一地板構件部份上之封閉外周的一第二地板構件部份，該第一地板構件部份包括用於行走於其上之一頂表面，該第二地板構件部份具有含周圍側邊緣之一底部份，該底部份形成有引導朝向該底部份之周圍側邊緣的數個濕氣分散路徑以允許發展於該地板基底及安裝於地板基底上之該地板構件之底部份之間的濕氣流動於該濕氣分散路徑中，而朝向該底部份之至少一周圍側邊緣，並通過至該底部份之至少一周圍側邊緣的外邊。

5

10
2. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其中該濕氣分散路徑包括通道，該通道被安排為引導至該底部份之至少一周圍側邊緣以通過至該底部份之至少一周圍側邊緣的外邊。

15
3. 如申請專利範圍第2項之地板構件，其中該通道包括間隔壁部份，該壁部份以重複圖案形成，使得該通道為該間隔壁部份之重複圖案所界定，藉此一預定量之該通道一個接著另一個備置。

20
4. 如申請專利範圍第2項之地板構件，其中該通道為間隔壁部份所界定，該間隔壁部份具有波浪形狀以界定該通道之一波浪路徑。
5. 如申請專利範圍第2項之地板構件，其中該通道為間隔

壁部份所界定，該間隔壁部份備置有中斷處。

6. 如申請專利範圍第5項之地板構件，其中該間隔壁部份中之預定中斷處係大致對齊以界定對齊中斷處的路徑，如此該濕氣分散路徑更包括該對齊中斷處之路徑，
5 該對齊中斷處之路徑被安排為引導至該底部份之至少一第二周圍側邊緣以允許濕氣經由該對齊中斷處之路徑通過至該底部份之至少一第二周圍側邊緣的外邊。
7. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其中數個該地板構件係以相鄰關係安裝在地板基底上而形成一地板覆蓋
10 安裝件以覆蓋一所欲量之該地板基底，該地板覆蓋安裝件具有最外周圍側邊緣，且該地板覆蓋安裝件之數個地板構件的濕氣分散路徑被形成，使得該數個地板構件之濕氣分散路徑的預定部份係溝通的以提供引導至該地板覆蓋安裝件之至少一最外周圍側邊緣的濕氣分散路徑，
15 來將流經該溝通的濕氣分散路徑的濕氣發散至該地板覆蓋安裝件之至少一最外周圍側邊緣。
8. 如申請專利範圍第1項之地板構件，更包括備置於該底部份之間隔突出管柱形成件，該突出管柱形成件具有一第一自由端表面，該間隔壁部份具有一第二自由端表面，
20 且其中該第一及第二自由端表面係大致上共平面以當該地板構件安裝在地板基底上時支持該地板構件之底部份，如此該濕氣分散路徑係在該地板基底上方。
9. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其中該第一部份包括一材料層，該材料係選自由木頭、地毯、軟木塞、塑

膠、橡膠及纖維板所組成之群組。

10. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其中該第二部份之底部份由防水塑膠材料形成。

5 11. 如申請專利範圍第10項之地板構件，其中該第二部份之底部份由聚氯乙烯形成。

12. 如申請專利範圍第1項之地板構件，包括用於連結該地板構件至呈相鄰關係之另一地板構件的連結構件。

10 13. 如申請專利範圍第1項之地板構件，包括用於連結該地板構件至數個呈相鄰關係之地板構件連結構件，其中該第一及第二地板構件部份具有側邊緣且以偏移關係層疊在一起，其中該第一及第二地板構件部份之偏移層疊界定該第一地板構件部份之第一偏移周緣部份及該第二地板構件部份之第二偏移周緣部份，該第一地板構件部份之第一偏移周緣部份延展至該第二地板構件部份之至少一側邊緣的外邊，且該第二地板構件部份之第二偏移周緣部份延展至該第一地板構件部份之至少一側邊緣的外邊，該地板構件的第一偏移周緣部份連結至呈相鄰關係之該數個地板構件的第二偏移周緣部份，且該地板構件之第二偏移周緣部份連結至呈相鄰關係之該數個地板構件之另一個的第一周緣部份。

15

20

14. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其係瓷磚地板的形式。

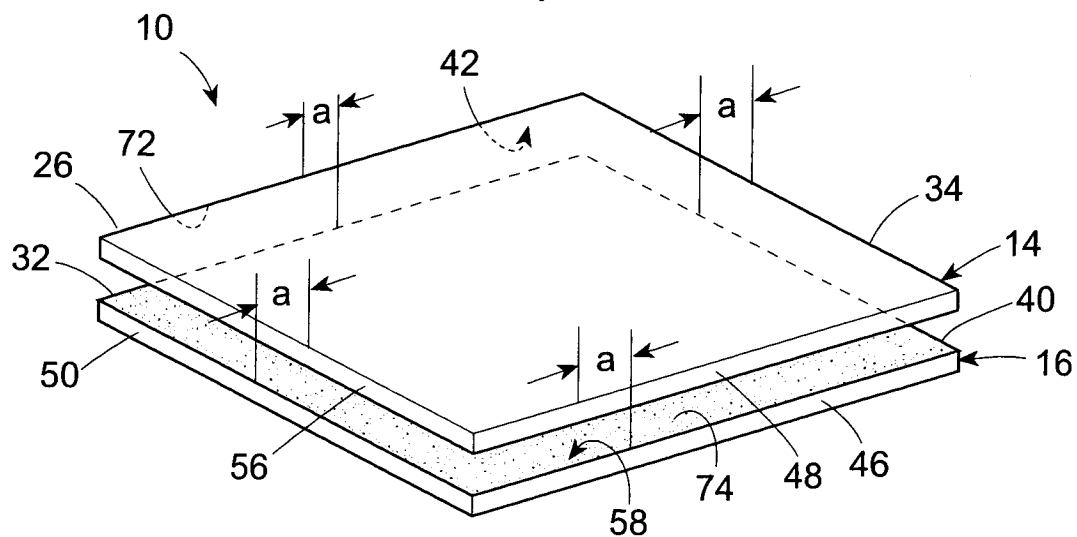
15. 如申請專利範圍第1項之地板構件，其係木板地板的形式。

16. 一種能夠使發展於地板基底與安裝在該地板基底上之地板構件之間的濕氣移動至該地板構件之最外邊緣以通過至該地板構件之最外邊緣之外邊的方法，包括：
- a) 於該地板構件備置有一第一地板構件部份，該第一地板構件部份具有用於走在其上之一頂表面，
 - b) 層疊該第一地板構件部份至一第二地板構件部份，該第二地板構件部份具有含周圍側邊緣之一防水塑膠底部份，及
 - c) 使該底部份形成有濕氣分散路徑，該濕氣分散路徑沿著該底部份延展至該底部份之周圍側邊緣以當安裝於該地板基底上而未結合或黏結至該地板基底時，使得發展於地板基底及該地板構件之底部份之間的濕氣能夠經由該濕氣分散路徑朝向該底部份之至少一周圍邊緣移動而通過至該底部份之至少一周圍側邊緣的外邊。
17. 如申請專利範圍第16項之方法，包括將該濕氣分散路徑形成為通道，該通道被安排為引導至該底部份之至少一周圍側邊緣以通過至該底部份之該周圍側邊緣的外邊。
18. 如申請專利範圍第17項之方法，包括以呈重複圖案之間隔壁部份形成該通道，如此該通道為該間隔壁部份的重複圖案所界定，且一預定量之該通道係一個接著另一個而備置。
19. 如申請專利範圍第18項之方法，包括於該壁部份中形成對應中斷處及對齊該壁部份中之對應中斷處，以界定該

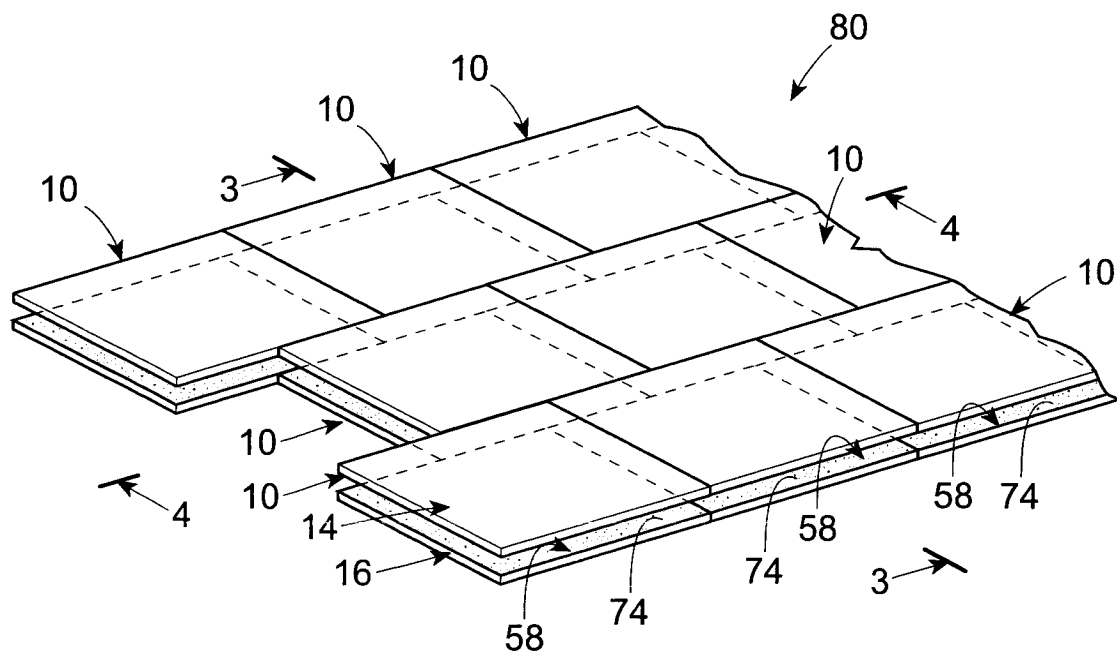
對齊中斷處的路徑及安排該對齊中斷處之路徑以引導至該底部份之至少一第二周圍側邊緣來允許濕氣經由該對齊中斷處之路徑通過至該底部份之第二周圍側邊緣的外邊。

- 5 20. 如申請專利範圍第16項之方法，包括以相鄰關係安裝數
個該地板構件於該地板基底上，以形成具有最外周圍側
邊緣之一地板覆蓋安裝件來覆蓋一所欲量的該地板基
底，及於每個該地板構件之底部份中形成濕氣分散路
徑，以允許相鄰地板構件之預定濕氣分散路徑之間的溝
10 通，使得濕氣可以朝向該地板覆蓋安裝件之至少一最外
周圍側邊緣移動來發散在該地板覆蓋安裝件之至少一
最外周圍側邊緣的濕氣。

第 1 圖

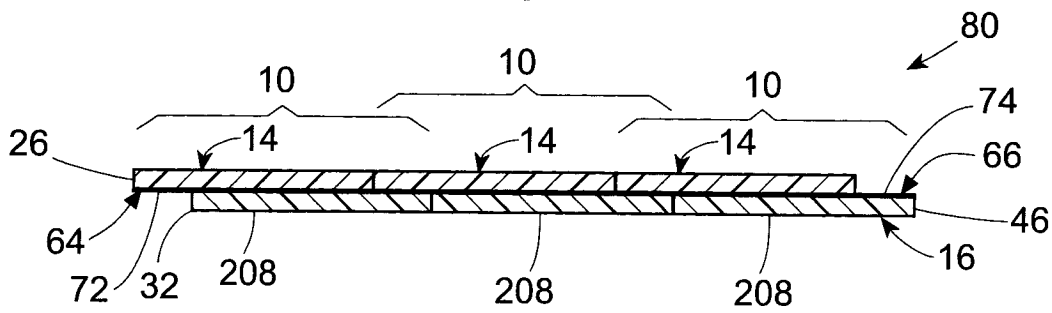


第 2 圖

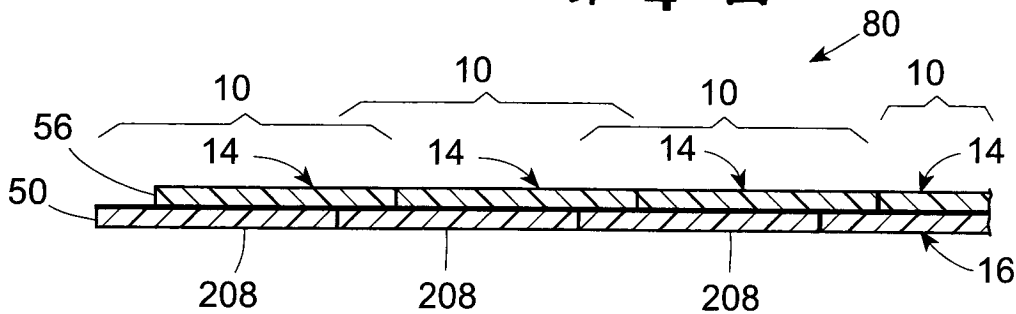


+

第 3 圖



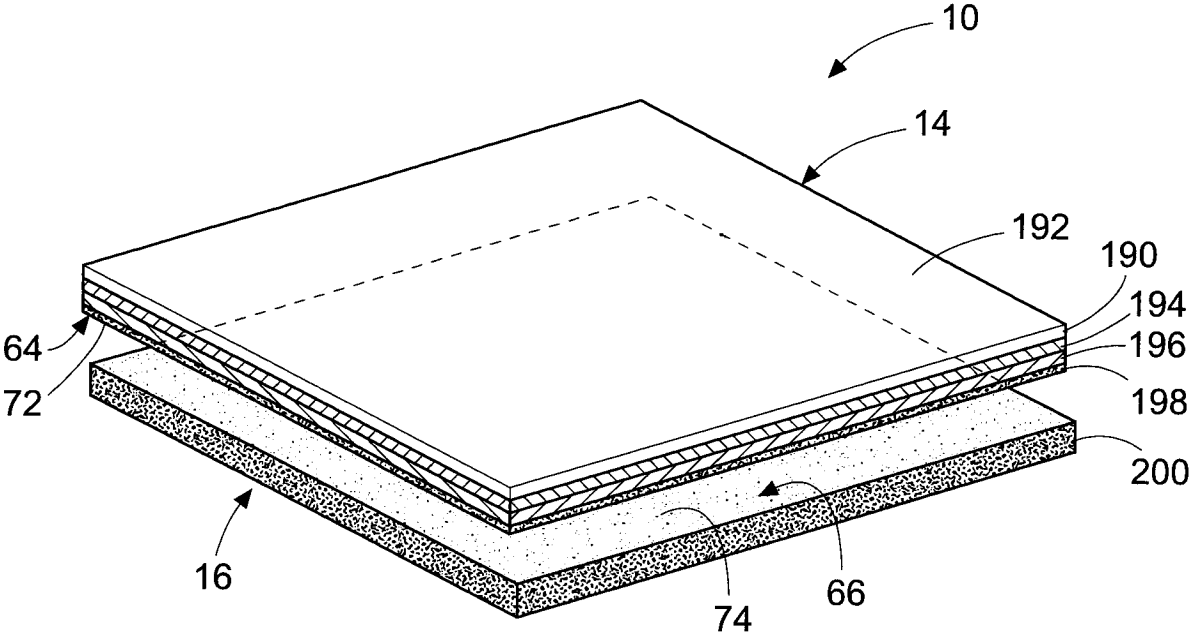
第 4 圖



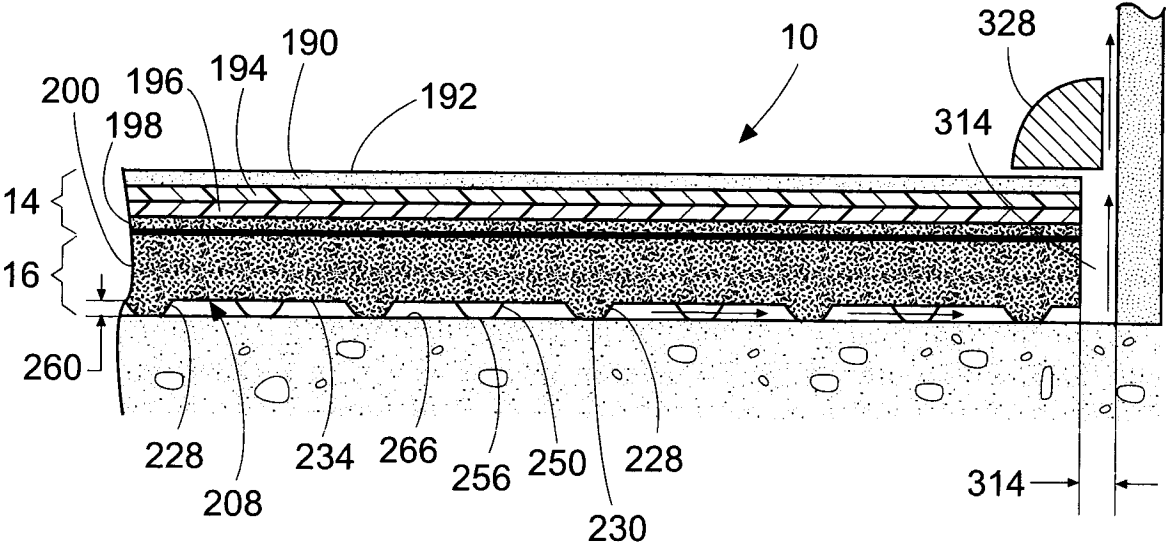
+



第 5 圖

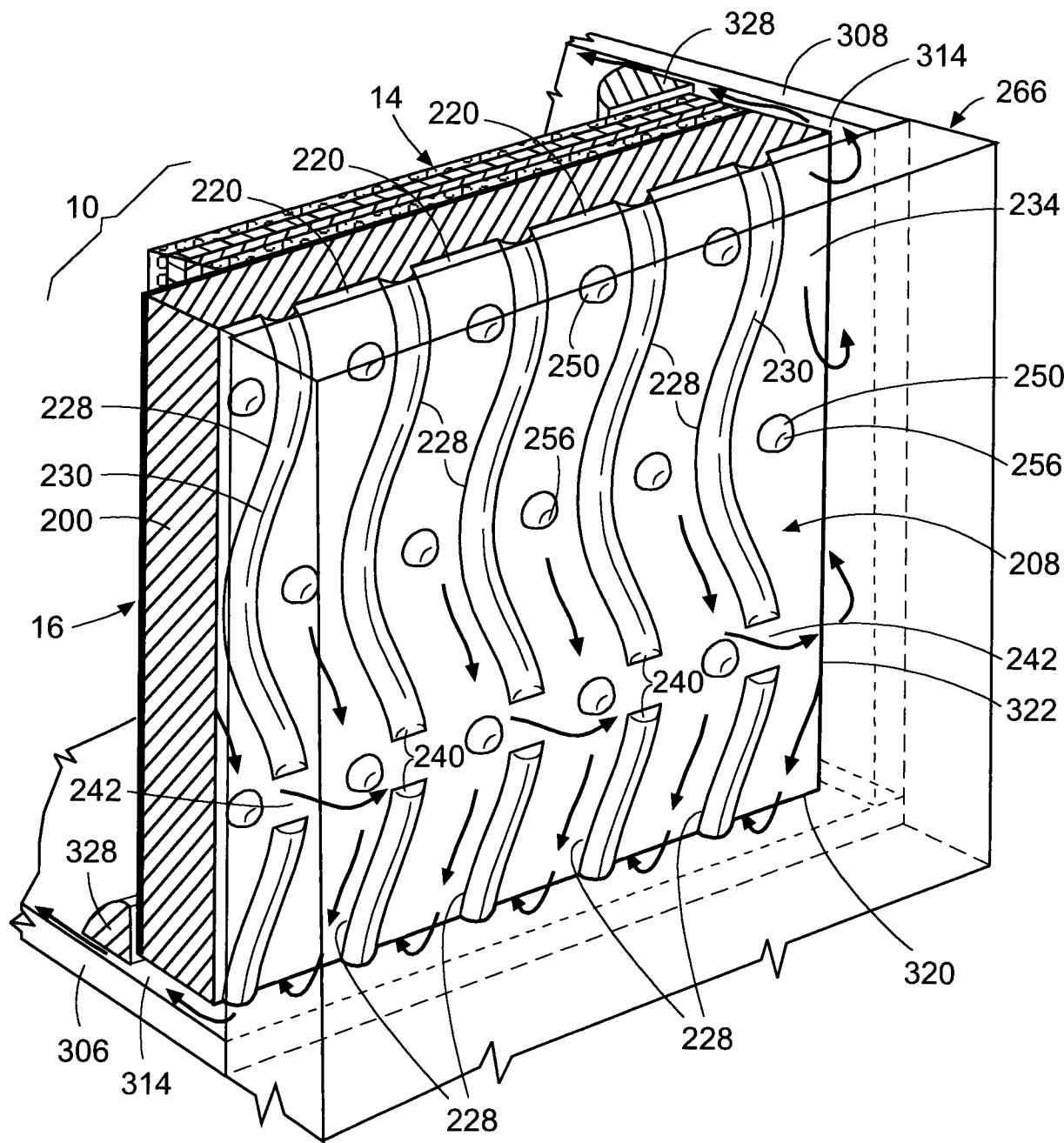


第 6 圖





第 7 圖

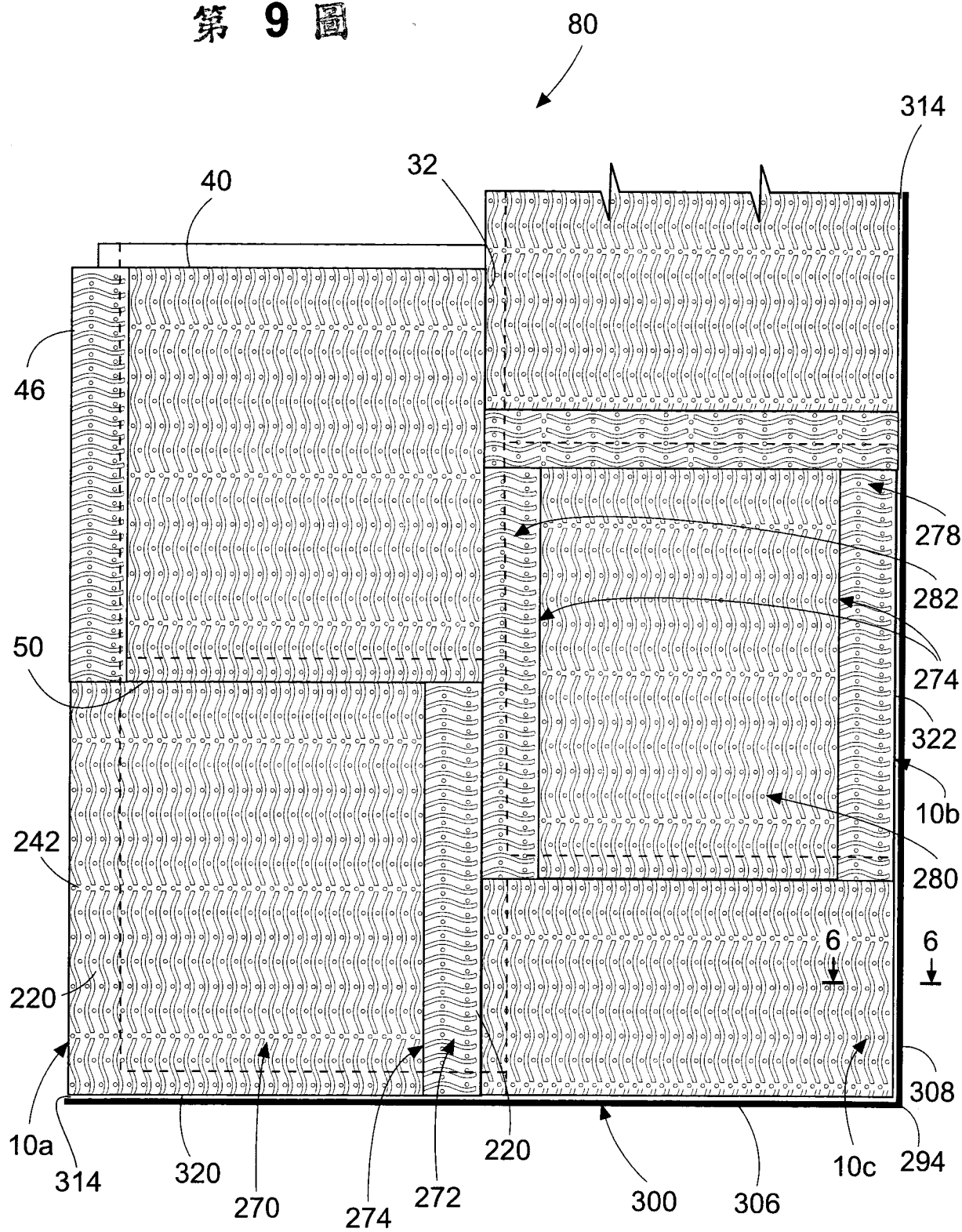


第 8 圖





第 9 圖



七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第 (1) 圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

10... 瓷磚地板	46... 側邊緣
14... 第一地板構件部份	48... 側邊緣
16... 第二地板構件部份	50... 側邊緣
26... 側邊緣	56... 側邊緣
32... 側邊緣	58... 偏移L形周緣段
34... 側邊緣	72... 黏著表面
40... 側邊緣	74... 黏著表面
42... 偏移L形周緣段	

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：